

ЛИСТ СОВМЕСТИМОСТИ

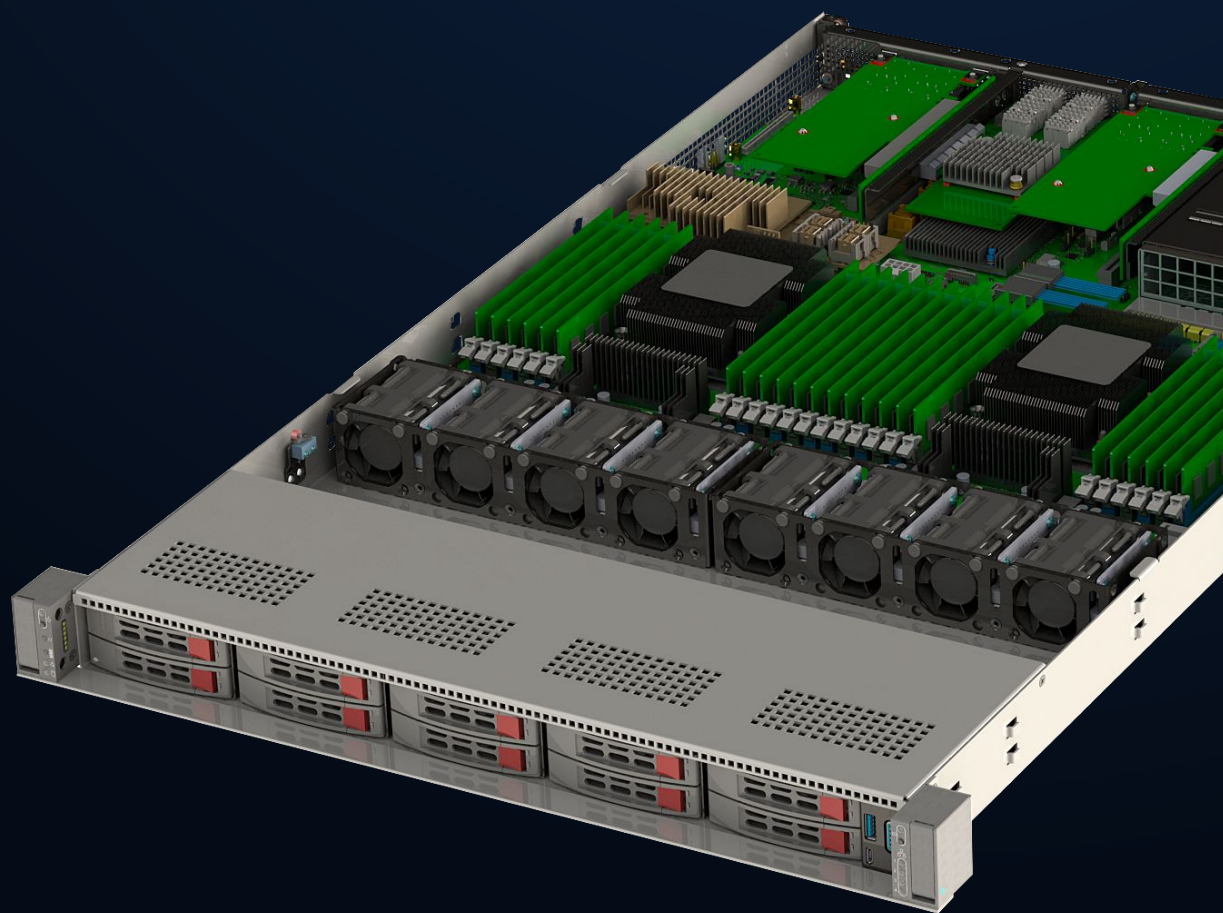
"НТ" Паладин-X110

Универсальная серверная платформа на базе Xeon Scalable Gen 2

До 2 процессоров

До 6 T6 DDR4

До 10 SFF дисков



Версия 0.1

Июль 2026

servers.nt.ru

"НТ" Паладин-X110

Высокопроизводительный двухпроцессорный сервер корпоративного класса для построения вычислительной инфраструктуры, виртуализации, систем хранения данных и задач искусственного интеллекта.



Внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ (реестровая запись № 10473163 от 21.08.2023)



Вид спереди



Вид спереди (без крышки)



Вид сзади



CPU

До 2х
Xeon Scalable Gen 2



ОЗУ

24 слота
До 6 Тб DDR4



ДИСКОВАЯ СИСТЕМА

До 10 шт. SAS/SATA 6/12G дисков 2.5" SFF;
До 10 шт. NVMe PCIe 4x дисков;
До 4 шт. NVMe PCIe 4x дисков и до 6 шт. SAS/SATA 6/12G дисков с возможностью горячей замены;
До 2 шт. NVMe PCIe 4x дисков и до 8 шт. SAS/SATA 6/12G дисков.
+2x M.2 дисков

Ключевые преимущества:

- ✓ Поддержка до 6 Тб оперативной памяти
- ✓ Внесен в Реестр МПТ РФ
- ✓ Горячая замена компонентов
- ✓ До 10 накопителей SFF
- ✓ Поддержка OCP 2.0

1. ОСНОВНЫЕ АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметры
Основные ресурсы	
Процессор	2 шт. Intel Xeon Scalable Gen 2 с TDP до 205 Вт
ОЗУ	До 24 шт. DDR4
Максимальный объем ОЗУ	6 ТБ
Чипсет	Intel® C624
ОСР 2.0	1 шт.
Дисковая подсистема	
Максимальное количество дисков 3'5 (LFF) в передней кассете	10 шт. SAS/STATA 10 шт. NVMe с PCIe x4 на каждый; 8 шт. SAS/SATA и 2 шт. NVMe с PCIe x4 на каждый; 6 шт. SAS/SATA и 4 шт. NVMe с PCIe x4 на каждый
M.2 SSD на материнской плате	2
Интегрированные интерфейсы	
1 Gbe Ethernet, портов	3 на тыльной панели
1Gbe BMC	1 на тыльной панели
USB 3.0	3 на тыльной панели и 1 на передней панели
VGA	1 на передней панели и 1 на задней панели
Электропитание и охлаждение	
Номинальная мощность, Вт	CRPS 1+1 БП, Поддержка БП по 2000Вт включительно
Напряжение	220В/48В
Системные вентиляторы	До 6 шт. До 48Вт на вентилятор. Поддержка высокооборотных вентиляторов
Габариты и масса	
Размеры (ШхВхГ), мм	483
x43x762	

1. ОСНОВНЫЕ АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Категория	Параметры
Габариты и масса (продолжение)	
Масса платформы, кг	15
Монтажный размер, U	1
Эксплуатационные параметры	Температура +15...30°C, Давление 630...800 мм рт ст

2. Поддерживаемые аппаратные компоненты

2.1 CPU

Наименование	Артикул	Ядра	Потоки	TDP, W
Процессор Intel Xeon Gold 5218	CD8069504193301	16	32	125
Процессор Intel Xeon Silver 4216	CD8069504213901	16	32	100
Процессор Intel Xeon Gold 5217	CD8069504214302	8	16	115
Процессор Intel Xeon Gold 6246	CD8069504282905	12	24	165
Процессор Intel Xeon Gold 6226	CD8069504283404	12	24	125
Процессор Intel Xeon Silver 4214R	CD8069504343701	12	24	100
Процессор Intel Xeon Silver 4210R	CD8069504344500	10	20	100
Процессор Intel Xeon Gold 6240R	CD8069504448600	24	48	165
Процессор Intel Xeon Gold 6226R	CD8069504448701	16	32	150
Процессор Intel Xeon Gold 6248R	CD8069504449000	24	48	205
Процессор Intel Xeon Gold 6242R	CD8069504449401	20	40	205
Процессор Intel Xeon Gold 6246R	CD8069504449801	16	32	205

2. Поддерживаемые аппаратные компоненты

2.2 ОЗУ

Фирма	Артикул	Частота, МГц	Объем, Гб
Samsung	M393A2K43CB2-CTD	2666	16
Samsung	M393A2K40EB3-CWE	3200	16
Samsung	M393A4K40CB2-CVF	2933	32
Samsung	M393A4G40BB3-CWEBY	3200	32
Samsung	M393A4K40DB3-CWE	3200	32
Samsung	M393A4K40DB3-CWE	3200	32
Samsung	M393A4K40EB3-CWE	3200	32
Samsung	M393A4K40EB3-CWEBY	3200	32
Samsung	M393A8G40MB2-CVFBY	2933	64
Samsung	M393A8G40AB2-CWE	3200	64
Samsung	M393A8G40BB4-CWE	3200	64
Samsung	M393A8G40CB4-CWE	3200	64
Samsung	M393AAG40M32-CAE	3200	128
Micron	MTA18ASF2G72PDZ-3G2R1	3200	16
Micron	MTA9ASF2G72PZ-3G2B1	3200	16
Micron	MTA36ASF4G72PZ-3G2R1	3200	32

2. Поддерживаемые аппаратные компоненты

2.3 Сетевые карты

Сетевые карты 1 Гбит/с

Производитель	Модель	Порты	Интерфейс
ASUS	90SC0AA0-MOUAY0	2x 1000BASE-T	PCI Express 2.0 x4

Ethernet 10 Гбит/с, оптика/DAC, SFP+

Производитель	Модель	Порты	Интерфейс
HPE	788995-B21	2 × 10GBASE-X	PCI Express x8, LP
LR-Link	LREC6822XF-2SFP+	2 × SFP+	PCIe 3.0 x8, LP
LR-Link	LREC9802BF-2SFP+	2 × SFP+	PCIe 3.0 x8, NIC
LR-Link	LREC9804BF-4SFP+	4 × SFP+	PCIe 3.0 x8, LP
LR-Link	LREC9812BF-2SFP+	2 × SFP+	PCIe 3.0 x8, LP
LR-Link	LRES3002PF-OCP	2 × SFP+	OCP x1, LP
Silicom	PE210G2SPI9A-XR	2 × SFP+	PCIe 3.0 x8, LP

Ethernet 25 Гбит/с, оптика/DAC, SFP28

Производитель	Модель	Порты	Интерфейс
LR-Link	LRES1026PF-2SFP28	2 × SFP28	PCIe 3.0 x8, LP
LR-Link	LRES1027PF-4SFP28	4 × SFP28	PCIe 4.0 x8, LP
LR-Link	LRES3017PF-OCP	2 × SFP28	PCIe 3.0 x16, NIC
Mellanox	MCX4121A-ACAT	2 × SFP28	PCIe 3.0 x8, LP
Mellanox	MCX4421A-ACQN	2 × SFP28	OCP x8, NIC

2. Поддерживаемые аппаратные компоненты

2.4 Система хранения

HDD 2,5" SAS

Модель	Объем	Интерфейс
Toshiba AL15SEB120N	1,2 ТБ	SAS, 12 Гбит/с
Toshiba AL15SEB24EQ	2,4 ТБ	SAS, 12 Гбит/с
Seagate ST2400MM0129	2,4 ТБ	SAS, 12 Гбит/с

SSD 2,5", SATA

Модель	Объем	Интерфейс
Foxline FLSSD240X5	240 ГБ	SATA, 540/560 МБ/с
Micron MTFDDAK960TDS	960 ГБ	SATA, 6 Гбит/с
Micron MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY	960 ГБ	SATA, 6 Гбит/с
Samsung MZ7L31T9HBLT-00A07	1,92 ТБ	SATA, 6 Гбит/с
Samsung MZ7L3240HCHQ-00A07	240 ГБ	SATA, 6 Гбит/с
Samsung MZ7L3480HCHQ-00A07	480 ГБ	SATA, 560/520 МБ/с
Samsung MZ7L37T6HBLA-00A07	7,68 ТБ	SATA, 520 МБ/с
Samsung MZ7LH240HANQ-00005	240 ГБ	SATA, 550/320 МБ/с
Samsung MZ7LH480HANQ-00005	480 ГБ	SATA, 6 Гбит/с
Samsung MZ7LH960HAJR-00005	960 ГБ	SATA, 6 Гбит/с
Kingston SEDC600M/3840G	3,84 ТБ	SATA, 560/530 МБ/с
Intel SSDSC2KB019TZ01	1,92 ТБ	SATA, 6 Гбит/с

SSD 2,5", SAS

Модель	Объем	Интерфейс
Samsung MZILT1T9HBJR-00007	1,92 ТБ	SAS, 24 Гбит/с
Samsung MZILT3T8HBLS-00007	3,84 ТБ	SAS, 12 Гбит/с

SSD 2,5", PCIe/NVMe

Модель	Объем	Интерфейс
Samsung MZQL21T9HCJR-00A07	1,92 ТБ	PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel SSDPF2KE016T1N1	1,6 ТБ	PCIe 4.0 x4
Intel SSDPF2KX019XZN1	1,92 ТБ	PCIe

SSD M.2, PCIe/NVMe

Модель	Объем	Интерфейс
Samsung MZ1L2960HCJR-00A07	960 ГБ	M.2 PCIe, 16 Гбит/с

SSD M.2 SATA

Модель	Объем
Transcend TS64GMTS400S	64 ГБ